

# 方正证券承销保荐有限责任公司

## 关于上海伟测半导体科技股份有限公司

### 2023 年半年度持续督导跟踪报告

根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号—持续督导》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》等有关法律、法规的规定，方正证券承销保荐有限责任公司（以下简称“保荐机构”）作为上海伟测半导体科技股份有限公司（以下简称“伟测科技”、“公司”、“上市公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，负责伟测科技上市后的持续督导工作。

#### 一、持续督导工作情况

序号	工作内容	持续督导情况
1	建立健全并有效执行持续督导工作制度，并针对具体的持续督导工作制定相应的工作计划	保荐机构已建立健全并有效执行了持续督导制度，并制定了相应的工作计划
2	根据中国证监会相关规定，在持续督导工作开始前，与上市公司或相关当事人签署持续督导协议，明确双方在持续督导期间的权利义务，并报上海证券交易所备案	保荐机构已与伟测科技签订《持续督导协议》，该协议明确了双方在持续督导期间的权利和义务
3	通过日常沟通、定期回访、现场检查、尽职调查等方式开展持续督导工作	保荐机构通过日常沟通、定期或不定期回访、现场检查、尽职调查等方式，了解伟测科技经营情况，对伟测科技开展持续督导工作
4	持续督导期间，按照有关规定对上市公司违法违规事项公开发表声明的，应于披露前向上海证券交易所报告，并经上海证券交易所审核后在指定媒体上公告	2023 年上半年度，伟测科技在持续督导期间未发生按有关规定需保荐机构公开发表声明的违法违规情况
5	持续督导期间，上市公司或相关当事人出现违法违规、违背承诺等事项的，应自发现或应当自发现之日起五个工作日内向上海证券交易所报告，报告内容包括上市公司或相关当事人出现违法违规、违背承诺等事项的具体情况，保荐人采取的督导措施等	2023 年上半年度，伟测科技及相关当事人在持续督导期间未发生需报告的违法违规、违背承诺等事项
6	督导上市公司及其董事、监事、高级管理人员遵守法律法规、部门规章和上海证券交易所发布的业务规则及其他规范性文件，并切实履行其所做出的各项承诺	在持续督导期间，保荐机构督导伟测科技及其董事、监事、高级管理人员遵守法律法规、部门规章和上海证券交易所发布的业务规则及

		其他规范性文件，切实履行其所做出的各项承诺
7	督导上市公司建立健全并有效执行公司治理制度，包括但不限于股东大会、董事会、监事会议事规则以及董事、监事和高级管理人员的行为规范等	保荐机构督促伟测科技依照相关规定健全完善公司治理制度，并有效执行公司治理制度
8	督导上市公司建立健全并有效执行内控制度，包括但不限于财务管理制度、会计核算制度和内部审计制度，以及募集资金使用、关联交易、对外担保、对外投资、衍生品交易、对子公司的控制等重大经营决策的程序与规则等	保荐机构对伟测科技的内部控制制度的设计、实施和有效性进行了核查，伟测科技的内控制度符合相关法规要求并得到了有效执行
9	督导上市公司建立健全并有效执行信息披露制度，审阅信息披露文件及其他相关文件，并有充分理由确信上市公司向上海证券交易所提交的文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏	保荐机构督促伟测科技有效执行信息披露制度，审阅信息披露文件及其他相关文件
10	对上市公司的信息披露文件及向中国证监会、上海证券交易所提交的其他文件进行事前审阅，对存在问题的信息披露文件及时督促公司予以更正或补充，公司不予更正或补充的，应及时向上海证券交易所报告；对上市公司的信息披露文件未进行事前审阅的，应在上市公司履行信息披露义务后五个交易日内，完成对有关文件的审阅工作，对存在问题的信息披露文件应及时督促上市公司更正或补充，上市公司不予更正或补充的，应及时向上海证券交易所报告	保荐机构对伟测科技的信息披露文件进行了审阅，不存在应及时向上海证券交易所报告的情况
11	关注上市公司或其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员受到中国证监会行政处罚、上海证券交易所纪律处分或者被上海证券交易所出具监管关注函的情况，并督促其完善内部控制制度，采取措施予以纠正	2023年上半年度，伟测科技及其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员未发生该等事项
12	持续关注上市公司及控股股东、实际控制人等履行承诺的情况，上市公司及控股股东、实际控制人等未履行承诺事项的，及时向上海证券交易所报告	2023年上半年度，伟测科技及其控股股东不存在未履行承诺的情况
13	关注公共传媒关于上市公司的报道，及时针对市场传闻进行核查。经核查后发现上市公司存在应披露未披露的重大事项或与披露的信息与事实不符的，及时督促上市公司如实披露或予以澄清；上市公司不予披露或澄清的，应及时向上海证券交易所报告	2023年上半年度，伟测科技不存在应及时向上海证券交易所报告的情况

14	发现以下情形之一的，督促上市公司做出说明并限期改正，同时向上海证券交易所报告：（一）涉嫌违反《股票上市规则》等相关业务规则；（二）中介机构及其签名人员出具的专业意见可能存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏等违法违规情形或其他不当情形；（三）公司出现《保荐办法》第七十条规定的情形；（四）公司不配合持续督导工作；（五）上海证券交易所或保荐人认为需要报告的其他情形	2023 年上半年度，伟测科技未发生相关情形
15	制定对上市公司的现场检查工作计划，明确现场检查工作要求，确保现场检查质量	保荐机构已制定对上市公司的现场检查工作计划，明确现场检查工作要求，确保现场检查质量
16	上市公司出现以下情形之一的，自知道或应当知道之日起 15 日内进行专项现场核查：（一）存在重大财务造假嫌疑；（二）控股股东、实际控制人及其关联人涉嫌资金占用；（三）可能存在重大违规担保；（四）控股股东、实际控制人及其关联人、董事、监事或者高级管理人员涉嫌侵占上市公司利益；（五）资金往来或者现金流存在重大异常；（六）上海证券交易所或者保荐人认为应当进行现场核查的其他事项。	2023 年上半年度，伟测科技不存在需要专项现场检查的情形

## 二、保荐机构和保荐代表人发现的问题及整改情况

无。

## 三、重大风险事项

2023 年上半年度（以下简称“报告期”），公司主要的风险因素事项如下：

### （一）公司发展需要投入大量资金的风险

集成电路测试行业属于资本密集型的重资产行业，测试产能规模是测试企业核心竞争力的重要体现之一。在对行业发展趋势保持清晰认知的基础上，公司为了维持自身核心竞争力需持续扩大测试设备规模，从而保证测试产能的充足，满足客户的不同测试需求。因此，公司需不断购置测试机、探针台和分选机等测试设备。与此同时，公司购置的测试机中，绝大部分是采购价格相对昂贵、交付周期相对较长的高端测试机，高端测试机对公司持续满足客户需求、公司自身测试相关的研发等方面都有着较大的影响，因此，如果公司未来融资渠道、融资规模受限，导致发展资金短缺，可能对公司的持续发展和市场地位造成不利影响。

## **（二）进口设备依赖的风险**

报告期内，公司持续扩张测试产能，固定资产规模持续增长。公司现有机器设备以进口设备为主，主要供应商包括爱德万、泰瑞达等国际知名测试设备厂商。公司进口设备主要是测试机、探针台、分选机及相关配件，是公司测试业务的关键设备。截至目前，公司现有进口设备及募集资金投资项目所需进口设备尚未受到进口“卡脖子”管制。若未来国际贸易摩擦特别是中美贸易冲突加剧，相关国家进一步加大对半导体生产设备的出口管制力度和范围，从而使公司所需的测试设备出现进口受限甚至无法进口的情形，将对公司生产经营产生不利影响。

## **（三）集成电路行业发展增速降低的风险**

2022年下半年以来，以消费电子为代表的部分芯片的需求处于下滑的趋势，相关设计公司因其库存较高而处在去库存的阶段。尽管公司集成电路测试产品用途的覆盖范围包括汽车电子、工业控制、消费电子等多种产品，且公司持续增大高端测试产能的投入，同时继续重视研发投入，紧跟行业发展步伐，抗行业波动能力相对较强，但如果集成电路行业整体增长减缓甚至停滞，将对公司业绩造成不利影响。

## **（四）集成电路测试行业竞争加剧的风险**

随着集成电路测试需求的不断扩大，独立第三方测试企业和封测一体化企业等各类测试服务商继续扩大产能、增加投入，市场竞争变得日趋激烈。若公司未来无法缩小与封测一体化企业和独立第三方测试头部企业之间的差距，将有可能在竞争中处于不利地位。

## **（五）技术更新不及时与研发失败风险**

随着集成电路行业自身的发展以及下游产品更新迭代的速度加快，高性能、多功能的复杂 SoC 以及各类先进封装形式的芯片渐成主流，公司研发的测试方案需要不断满足高端芯片对测试的有效性、可靠性、稳定性以及经济性的需求，研发难度大大增加。此外，客户的测试需求也在不断变化，各类定制化要求层出不穷，公司要随之更新测试技术以适应市场的变化。如果公司未能在技术研发上持续投入，未能吸引和培养更加优秀的技术人才，可能存在研发的测试方案或开

发的测试技术不能达到新型芯片产品的测试指标，导致研发失败的风险，进而对公司的经营造成不利影响。

#### **（六）研发与技术人才短缺或流失的风险**

集成电路测试行业属于技术密集型产业，测试方案开发、测试量产都依赖于理论知识和工程经验丰富的技术人员。目前，与广阔的市场空间相比，专业测试研发技术人员相对匮乏。此外，同行业竞争对手可能通过更优厚的待遇吸引公司技术人才，同时，公司可能会受其他因素影响导致技术人才流失。上述情况将对公司测试方案的研发以及测试技术能力、测试技术人才的储备造成不利影响，进而对公司的盈利能力产生一定的不利影响。

#### **（七）公司经营业绩无法保持增长并且出现下滑的风险**

2023 年上半年度，公司实现营业收入 31,188.24 万元，同比下降 12.38%，实现归属于上市公司股东的净利润 7,076.34 万元，同比下降 37.96%。公司营业收入及净利润的情况主要与集成电路行业是否处于景气周期、集成电路测试行业的国产化进展以及公司自身竞争力状况相关。如果未来集成电路产业景气度继续延续 2022 年下半年起的相关趋势保持下降，行业竞争加剧，以及公司无法在技术实力、产能规模、服务品质等方面保持竞争优势，或者公司未能妥善处理快速发展过程中的经营问题，公司将面临经营业绩无法保持增长并且出现下滑的风险。

#### **（八）主营业务毛利率下降的风险**

公司主营业务毛利率与产能利用率、测试设备折旧、人力成本、主要原材料价格波动、市场供需关系等经营层面变化直接相关。同时，由于公司测试平台及配置种类较多，不同平台和配置的单价及成本差异较大，因此平台和配置的结构变化也会对公司主营业务毛利率产生较大影响。若未来上述因素发生不利变化比如产能利用率下降、设备折旧增加、人力成本上升或市场需求萎缩导致服务价格下降、成本上升，则公司主营业务毛利率可能出现下降的风险。

### **四、重大违规事项**

2023 年上半年度，公司不存在重大违规事项。

## 五、主要财务指标的变动原因及合理性

2023 年上半年度，公司主要财务数据及指标如下：

### （一）主要会计数据

单位：元

主要会计数据	2023年1-6月	2022年1-6月	本期比上年同期增减（%）
营业收入	311,882,355.75	355,967,125.13	-12.38
归属于上市公司股东的净利润	70,763,441.25	114,052,375.24	-37.96
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	52,647,647.44	109,529,822.61	-51.93
经营活动产生的现金流量净额	179,217,674.73	286,163,967.86	-37.37
主要会计数据	2023年6月末	2022年年末	本期末比上年度末增减（%）
归属于上市公司股东的净资产	2,376,482,037.35	2,379,462,892.35	-0.13
总资产	3,384,926,078.66	3,385,305,405.75	-0.01

### （二）主要财务指标

主要财务指标	2023年1-6月	2022年1-6月	本期比上年同期增减（%）
基本每股收益（元/股）	0.81	1.74	-53.45
稀释每股收益（元/股）	0.81	1.74	-53.45
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.60	1.67	-64.07
加权平均净资产收益率（%）	2.95	11.93	减少8.98个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	2.19	11.46	减少9.27个百分点
研发投入占营业收入的比例（%）	12.40	8.03	增加4.37个百分点

2023 年上半年度，公司主要财务数据及指标变动的的原因如下：

报告期内，公司实现营业收入 31,188.24 万元，较上年同期下降 12.38%；实现归属于上市公司股东的净利润 7,076.34 万元，较上年同期下降 37.96%。截至 2023 年 6 月 30 日，公司总资产 338,492.61 万元，归属于上市公司股东的净资产 237,648.20 万元，均与上年年末基本持平。经营活动产生的现金流量净额变动主要系税费返还金额变动所致。

2023 年上半年半导体市场延续了 2022 年的结构性分化态势，以消费电子为代表的产品受到终端需求的影响，整体需求出现下滑，市场相对低迷；以汽车电

子、工业类为代表的产品市场需求较为旺盛，仍保持一定的增长。

2023年第一季度由于处在行业淡季，订单量下降，加之半导体行业的波动，对公司业绩产生了一定的影响。但自2023年第二季度起，公司业务开始进入逐步恢复的阶段，2023年第二季度，公司实现营业收入17,175.62万元，较第一季度环比增长22.57%；实现净利润4,345.44万元，较第一季度环比增长59.12%，均有较大幅度的提升，公司2023年第二季度的订单量及产能利用率较2023年第一季度均有所恢复，预计今年订单整体呈现“前低后高”的态势。

报告期内，公司持续加大研发投入，研发投入占2023年上半年度营业收入的比例为12.40%，公司在车规级、工业类、大容量存储器及高算力、复杂的SoC芯片的测试、老化测试及大数据处理等方向进行重点研发，进一步突破不同种类高端芯片的测试难点，有助于提升公司测试服务的品质和效率、提升客户粘性，为公司可持续发展打下了坚实的基础。通过加大研发投入尤其是高端测试研发投入的举措，有利于公司在从行业低迷到逐步复苏的大背景下持续提升自身核心竞争力，为满足客户的后续需求做好准备。

综上，公司2023年1-6月主要财务数据及财务指标变动具备合理性。

## 六、核心竞争力的变化情况

公司核心竞争力如下：

### （一）测试设备规模及测试产能优势

公司固定资产中绝大部分为测试专用设备，通常情况下，测试设备规模与测试产能规模呈现正相关的关系。基于公司自身战略规划考量、兼顾不同客户的不同测试需求以及对行业整体发展的认知，公司重视测试产能规模尤其是高端测试产能规模的扩张，报告期内，公司根据自身扩产计划以及客户需求，在原有设备的基础上陆续增加购进高端测试相关设备。足够的测试产能能够满足不同客户的不同测试需求，在行业处于相对上行的周期时能够快速响应客户的测试需求，在行业处于相对下行的周期时能够保证一定的生产规模，从一定程度上抵消行业波动对公司经营产生的不良影响。

足够的产能规模能够吸引客户的重视，是接受行业内高端测试客户订单的必要条件，截至2023年6月末，公司的高端测试产能在中国大陆独立第三方测试

企业中处于相对领先水平，在此基础上，公司进一步夯实了公司在中国大陆独立第三方测试企业中的行业领先地位。

## （二）区位优势

进入 2023 年，公司继续深耕长三角市场。除贴近上海张江集成电路产业集群的公司上海本部外，公司先后在江苏省无锡市及江苏省南京市设立全资子公司，分别贴近当地的集成电路市场，更加便捷地满足当地客户对晶圆测试及芯片成品测试的需求，同时有利于上下游之间技术层面交流方面的便利，在此基础上获取客户的信任，深化合作。同时，长三角区位条件优越，交通运输便捷，公司立足于长三角有利于降低运输成本，缩短供应链周期。公司的发展离不开各模块的人才，长三角高校众多，在人才招聘上有着巨大优势。另外，长三角各地区在产业政策和招商引资上也存在着丰富的优势。

## （三）技术优势

公司的技术优势主要体现在测试技术水平领先、测试方案开发能力强及生产自动化程度高三个方面。

1、在测试技术水平方面，公司在晶圆尺寸覆盖度、温度范围、最高 Pin 数、最大同测数、最小 Pad 间距以及芯片成品测试的封装尺寸大小、测试频率等参数上在国内处于领先水平，并与国际巨头持平或者接近。

2、在测试方案开发能力方面，公司突破了 5nm-14nm 先进制程芯片、5G 射频芯片、高性能 CPU 芯片、高性能计算芯片、FPGA 芯片、复杂 SoC 芯片等各类高端芯片的测试工艺难点，同时，公司工业级、车规级及高算力产品的测试研发是公司重点的研发方向，公司进一步加大相关研发投入的力度，目前公司具备相关的测试能力，获得了客户的信任。公司积极开发各类高端芯片测试方案，在一定程度上成功实现了国产化替代。

3、在生产自动化程度方面，公司对标国际巨头，通过将测试作业中积累的技术和经验融入 IT 信息系统，自主开发了符合行业特点的生产管理系统，提升了测试作业的信息化、自动化、智能化水平，提高了测试作业的准确率和效率。

#### （四）客户优势

在外部贸易环境以及技术限制仍处于相对恶劣的情况下，中国大陆更多的集成电路设计公司出于对其自身测试服务需求的把控以及风险控制，将其测试业务供应商的选择由境外转向境内。在此大背景下，公司积极扩大高端测试产能，加大相关研发投入，提高自身测试服务品质，得到了行业内客户的高度认可，成为了中国大陆集成电路设计公司高端芯片测试国产化替代的重要供应商之一。截至目前，公司客户超过 200 家，客户类型广泛，包括了集成电路设计公司、晶圆制造企业、IDM 企业和封装企业，公司高端客户的质量和数量在中国大陆行业内保持领先。

#### （五）人才优势

公司核心团队在集成电路行业深耕细作二十余年，团队成员先后在摩托罗拉、日月光、长电科技等业内知名半导体企业从事研发、生产和管理工作，积累了极其丰富的行业经验，对于行业的发展趋势和市场需求的判断存在着自身独到的见解。在集成电路测试方面，公司核心团队对测试技术包括测试方案的开发、测试车间 IT 自动化管理及调试、提高测试生产效率、提升量产规模等方面有着丰富的经验。报告期内，公司继续加强研发人员的培养和引进，截至 2023 年 6 月 30 日，公司研发人员共计 297 人，占公司员工总数的比重为 23.39%，强大的研发团队保障了公司在核心技术方面的领先地位。

2023 年上半年度公司核心竞争力未发生重大不利变化。

### 七、研发支出变化及研发进展

#### （一）研发支出情况

2023 年 1-6 月，公司研发费用为 3,867.64 万元，同比增长 35.37%，主要由以下原因所致：

- 1、公司设置阶梯式培养研发储备人员的培养方式，持续加大培养力度；
- 2、为满足客户相关需求，在市场发展趋势的基础上，公司在重点研发方向（车规级、工业类、大容量存储器及高算力、复杂的 SoC 芯片的测试、老化测试及大数据处理等方向）持续投入开发力度，研发投入有所增加；

3、公司为满足高端测试方案需求以及提升测试效率，增加采购研发用高端测试机台。

报告期内，公司研发投入占营业收入的比例为 12.40%，较上年同期增加 4.37 个百分点。

## （二）研发进展

### 1、报告期内研发成果

2023 年 1-6 月，公司研发工作有序推进。公司新增发明专利申请 1 项、实用新型专利申请 11 项、软件著作权申请 10 项。2023 年上半年，公司新获得实用新型专利 12 项、软件著作权 12 项。

### 2、在研项目情况

单位：万元

序号	项目名称	预计总投资规模	本期投入金额	累计投入金额	进展或阶段性成果	拟达到目标	技术水平	具体应用前景
1	高性能车规级芯片综合测试方案的开发	180.00	57.72	161.96	已结项	以 5G 为代表的新型电子通讯产品的出现，对汽车的综合布线和信息的共享交互提出了更高的要求。因此研究一种高覆盖率高并行度测试汽车电子总线协议的自动化方法对高性能车规级芯片综合测试技术的开发起到关键性的作用。	国内领先	本项目已成功转化 1 项成果“一种高覆盖率高并行度测试汽车电子总线协议产品自动化测试方法”，相关技术已应用进生产过程，所制目标产品已成功推向市场，满足了客户需求并得到客户高度认可，并将其测试方法推广到其他有相关功能模块的车规芯片的测试，提高测试的覆盖率。
2	探针台改机自动抓取数据分析改造研发	1,050.00	414.96	414.96	研发阶段	根据客户需求，不同产品之间切换过程，定制自动切换的方式，以达到自动化产线标准。	国内领先	探针台和测试机之间通过通讯完成自动抓取数据，并进行自动分析，以达到产品切换的数据要求。
3	CP 设备图片自动分析功能研发	350.00	132.37	132.37	研发阶段	通过设计一套 AI 图片分析系统，针对在线作业过程中需要图片分析判读的进行自动判读，以达到自动分析，自动处理数据的功能。以满足自动化产线需	国内领先	该项目可以转换为“AOI 设备图片自动分析判读”；“prober PMI 图片自动分析判读”；“OM 设备图片自动分析判读”等多项目，可满足在线作业多种场景下的图片自动分析功能。

						求。		
4	车规级低温高湿老化实验（二期）	650.00	248.28	248.28	研发阶段	<p>以客户为需求导向，根据不同产品、条件、环境下的老化需求，进行定制化的制定老化方案；客户定制化功能板开发：根据老化方案的步骤，先期由供应商进行功能板和老化板夹具的开发，并进行定制化开发驱动；后期由公司自行研发；硬件及软件综合开发调试：半导体器件失效分析就是通过对失效器件进行而各种测试和物理、化学、金相试验，确定器件失效的形式（失效模式），分析造成器件失效的物理和化学过程（失效机理），寻找器件失效原因，制定纠正和改进措施。</p>	国内领先	<p>失效分析的一般程序包括：收集失效现场数据、电测确定失效模式、方案设计、非破坏性分析、打开封装、镜检、通电激励芯片、失效定位、对失效部位进行物理化学分析、综合分析确定失效原因，提出纠正措施等。</p>
5	恒温恒湿防尘防静电智能管理老化板仓储管理	400.00	165.43	165.43	研发阶段	<p>防静电设计：该类型的储存柜采用防静电材料和设计，以减少或消除静电的积累和释放。这有助于防止对存储的物品，如电子元件或精密仪器等，造成静电损害。</p> <p>恒温控制：储存柜内部配备温度传感器和恒温控制系统，可以实时监测和调节柜内的温度。恒温功能可提供稳定的温度环境，防止温度波动对物品造成损害。</p> <p>恒湿控制：储存柜也配备湿度传感器和恒湿控制系统，以监测和维持柜内的湿度水平。恒湿功能可确保物品在</p>	国内领先	<p>防静电恒温恒湿储存柜广泛应用于老化板的存放，Socket 的存放，客户特殊治具的存放，以确保对静电敏感的物品的安全储存和保护。它们对于存储电子元件、精密仪器、光学器件、电子设备和敏感材料等具有关键重要性。</p>

						<p>适宜的湿度条件下存储,防止湿度变化引发静电问题或腐蚀性损害。</p> <p>安全保护: 储存柜通常具备安全保护措施,如安全锁、报警系统和监控设备,以确保存储物品的安全性和防止未经授权的访问。</p> <p>节能设计: 该类型的储存柜还注重节能和环保设计。采用高效能的绝缘材料、节能设备和智能控制系统,以降低能源消耗,并减少对环境的不良影响。</p> <p>空气过滤和循环: 储存柜内部配备空气过滤系统,可以过滤和清洁空气中的灰尘、颗粒物和污染物。同时,空气循环系统可以保持柜内的空气流动,避免局部气候不均,确保温湿度均匀分布。</p> <p>可调节的储存空间: 柜内通常设置可调节的储存空间,以适应不同尺寸和类型的物品。可根据具体需求进行灵活调整,提供良好的储存环境。</p>		
6	多尺寸视觉防混防反全自动旋盖老化板上下料设备	850.00	333.86	333.86	研发阶段	<p>自动识别产品方向,纠正放置方向。OCR 字符识别与绑定。</p> <p>设备支持反向下料。可 Load 前道数据分类下料。</p> <p>开放式编程管理。用户工程人员可自行添加程序。</p> <p>设计具备一定的兼容性,可适应不同尺寸的</p>	国内领先	<p>设备用于 BGA、CSP、QFN、QFP 等不同类别的 IC 芯片切割分粒后自动上料到测试 Socket。</p> <p>设备自动识别开合 Socket。取放精度 <math>\pm 0.02\text{mm}</math>。</p>

						产品切换使用。		
7	基于 93K 及 J750 平台的测试方案开发（三期）	2,500.00	902.98	902.98	研发阶段	使用 93K 和 J750 测试设备完成对车规级高性能 32 位 MCU 晶圆整体测试测试解决方案、国产高性能国产 CPU 测试解决方案、Wifi7 高性能射频系统芯片、高精准时钟芯片测试解决方案和医用高性能 CIS 传感器芯片晶圆测试方案这 5 类标的芯片测试解决方案进行相关的开发/验证。其主要特色为：进行高稳定性高覆盖率车规级产品整体测试方案开发以及复杂多流程测试开发及工程流程开发以实现车规级芯片对于品质的 0 缺陷追求；实现对于高精度时钟信号芯片的 +/-0.5ppm 测试精度的需求；设计通用的 CPU 测试方案以加速国产 CPU 的产品的设计开发周期；实现使用高速信号通道进行 DFT Pattern 的设计；高带宽射频系统芯片进行全面系统的测试分析；大靶面高精度 CIS 传感器芯片的通用测试方案开发。	国际先进	使用 93K 和 J750 平台进行车规级高性能 32 位 MCU 芯片、国产高性能国产 CPU 芯片、Wifi7 高性能射频系统芯片、高精准时钟芯片和医用高性能 CIS 传感器芯片产品进行测试方案开发以解决这几类产品在 93K 及 J750 测试平台的技术挑战，形成完善的测试解决方案以最终实现这几类产品在 93K 及 J750 测试平台快速量产导入和稳定测试。另外，本次方案开发也可以针对产品形成通用的测试电路设计和程序代码库以缩短实际量产产品的开发周期和费用投入。
8	基于模拟平台的测试方案开发（三期）	950.00	400.75	400.75	研发阶段	使用模拟测试设备完成汽车电子动力驱动晶圆晶圆测试方案、高性能低压差线性稳压芯片测试解决方案、车规级通信总线芯片测试解决方案和高精度阈值电路保护芯片晶圆测试方案这 4 类标	国际先进	使用模拟测试设备进行汽车电子动力驱动芯片、高性能低压差线性稳压芯片、车规级通信总线芯片和高精度阈值电路保护芯片进行测试方案开发以解决这几类产品在模拟测试平台的技术挑战，形成完善的测试解决方案以最终实现这几

						的芯片测试解决方案开发和验证。其主要特色为：高测试精度，其中电压测试精度为 $\pm 0.1\text{mV}$ 数倍于测试设备精度；极高的参数测试测试结果一直性；良好的测试成本控制。		类产品在模拟测试平台快速量产导入和稳定测试。另外，本次方案开发也可以针对产品形成通用的测试电路设计和程序代码库以缩短实际量产产品的开发周期和费用投入。
9	基于 Chroma 平台的测试方案开发（三期）	700.00	275.24	275.24	研发阶段	使用 Chroma 测试设备完成 5G 毫米波射频前端芯片晶圆测试方案、车规级 MCU 芯片晶圆测试方案、车规级高精度 ADC 芯片晶圆低成本测试方案这 3 类标的芯片测试解决方案开发和验证。其主要特色为：低成本高测试覆盖率；高并行度；高稳定性；对于射频晶圆测试极大的幅度降低硬件规格的需求；大幅度提升射频前端在晶圆测试的稳定性；测试方案有良好可移植特性能够大幅度降低实际产品测试开发周期。	国际先进	使用 Chroma 进行 5G 毫米波射频前端芯片晶圆、车规级 MCU 芯片晶圆、车规级高精度 ADC 芯片行测试方案开发以解决这几类产品的技术挑战，形成完善的测试解决方案以最终实现这几类产品在 Chroma 进行测试平台的技术挑战，形成完善的测试解决方案以最终实现这几类产品在 Chroma 测试平台快速量产导入和稳定测试。另外，本次方案开发也可以针对产品形成通用的测试电路设计和程序代码库以缩短实际量产产品的开发周期和费用投入。
10	人工智能芯片可靠性验证平台（二期）	400.00	165.18	165.18	研发阶段	功能板开发：根据老化方案的步骤，先期由供应商进行功能板和老化板夹具的开发，并进行定制化开发驱动；后期由公司自行研发；硬件及软件综合开发调试：目前公司有程序的软件架构，可把功能板和夹具板的驱动进行系统软体整合，加快开发调试进程。	国内领先	构建先进的老化系统平台，加强技术核心的突破，形成新的信息高地，提高工作效率，增强宏观调控和科学决策水平。为各层级决策者提供实时的决策支持及灵活的预测分析，根据市场的变化及时调整策略，辅助领导决策。
11	集成电路芯片实时参数级智能测试分析平台（二期）	450.00	185.00	185.00	研发阶段	整合散落在各个业务系统中的多个信息孤岛，把数字技术与人员、生产设备和制造场景等紧密联结起来，以	国内领先	项目关键技术必须设计一套既符合现有公司生产模式的流程及架构，又必须预留广阔的升级发展空间，同时项目整合和多系统运作，

						现实需求为导向,构建一个稳定的、能抗源变化的、保存最细粒度历史数据的数据层,增强公司的数据收集、数据分析能力,并构筑一个集成生产信息、业务流程、客户资料、数据处理及应用共享的大数据平台,促进公司数字化转型目标的达成。		及多平台开发 VB JAVA 多数据格式,需准备配置数据库,数据模型及转换参数。本项目的难点是多平台多规格数据融合统一,及信息安全控制,测试数据包含了集成电路关键技术数据,知识产权等信息,必须放在首要考虑位置。
12	晶圆级大容量存储器测试技术的降本增效研究	408.00	194.52	313.28	研发阶段	为了降低企业的测试成本、提高企业产品品质和测试效率,伟测成立开发小组,对于晶圆级大容量存储器测试技术方案进行优化,通过改进算法,降低对硬件的需求,从而实现降本增效的目的。	国内领先	本项目已成功转化1项成果“一种实现在没有 ALPG 功能 ATE 测试 Memory 读写的方法”,相关技术已应用进生产过程,所制目标产品已成功推向测试技术的开发环节,在类似低成本晶圆存储器测试方案中有较好的应用价值。
13	芯片级高速总线测试效率提升的可行性研究	450.00	218.03	356.15	研发阶段	基于上述测试机 AC 参数的测试遇到的一些问题和挑战,本项目的目的是致力于研发低端测试机使用改良的测试方法下完成 AC 参数的测试,可以有效提高芯片测试精确度,对芯片级高速总线测试效率有明显提升。	国内领先	本项目已成功转化1项成果“一种提高 ATE 传输延迟测试准确度的方法”,相关技术已应用进生产过程,所制目标产品已成功推向市场,将在相关芯片测试方案中推广该测试方法,有效提高测试的经济性。
14	芯片测试可靠性验证平台开发	345.00	173.32	275.02	研发阶段	为了提高产品的质量,公司成立自动化数据小组,通过软件自动检测 Mapping 异常, Mapping 合并,处理复杂的数据,达到自动实时检测测试机芯片图异常、外观检芯片图和测试机芯片图合并、实时自动化处理复杂流程芯片图的目的。	国内领先	本项目已成功转化3项成果“伟测实时自动化处理复杂流程芯片图软件”、“伟测外观检芯片图和测试机芯片图合并软件”、“伟测自动实时检测测试机芯片图异常软件”,相关技术已应用进生产过程,所制目标产品已成功推向市场,满足了客户需求并得到客户高度认可。
合计	/	9,683.00	3,867.64	4,330.46	/	/	/	/

## 八、新增业务进展是否与前期信息披露一致

不适用。

## 九、募集资金的使用情况是否合规

根据中国证券监督管理委员会《关于同意上海伟测半导体科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1878号），公司由主承销商方正证券承销保荐有限责任公司采用包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票2,180.27万股，发行价为每股人民币61.49元，共计募集资金1,340,648,023.00元，坐扣承销和保荐费用78,162,309.27元后的募集资金为1,262,485,713.73元，已由主承销商方正证券承销保荐有限责任公司于2022年10月21日汇入公司募集资金监管账户。另减除审计及验资费用、律师费用、信息披露费用、发行手续费及其他费用等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用25,306,164.68元后，公司本次募集资金净额为1,237,179,549.05元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2022〕6-69号）。

截至2023年6月30日，公司募集资金使用和结余情况如下表所示：

金额单位：人民币万元

项目	序号	金额	
募集资金净额	A	123,717.95	
截至期初累计发生额	项目投入	B1	35,430.68
	利息收入净额	B2	287.90
本期发生额	项目投入	C1	59,225.33
	利息收入净额	C2	814.21
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1	94,656.01
	利息收入净额	D2=B2+C2	1,102.11
应结余募集资金	E=A-D1+D2	30,164.05	
实际结余募集资金	F	30,074.44	
差异	G=E-F	89.61	

[注 1]实际结余募集资金包括募集资金专户存款余额10,074.44万元，购买理财产品尚未到期金额20,000.00万元。

[注 2]差异系公司使用自有资金支付30.95万元印花税所致，无锡伟测半导体科技有限公司

集成电路测试产能建设项目全部投资款项支付完成后账户余额 120.56 万元转一般户补充流动资金所致，故实际募集资金结余较应结余募集资金少 89.61 万元。

截至 2023 年 6 月 30 日，募集资金专户余额情况如下表所示：

金额单位：人民币元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
交通银行上海张江支行	310066865013006192536	329,060.56	募集资金专户余额
兴业银行股份有限公司上海杨浦支行	216190100100229975	31,642,765.24	募集资金专户余额
兴业银行股份有限公司上海杨浦支行	216190100100229975	150,000,000.00	结构性存款
招商银行上海市张杨路支行	121933078910214	145.16	普通活期存款利息收入
申万宏源证券有限公司上海陆家嘴环路营业部	1633056575	650,853.80	收益凭证利息收入
申万宏源证券有限公司上海陆家嘴环路营业部	1633056575	50,000,000.00	收益凭证
招商银行无锡分行新区支行	511903003310604	106.09	募集资金专户余额
光大银行无锡分行营业部	39920180800378858	23,718,088.25	募集资金专户余额
交通银行南京鼓楼支行	320006600013002774567	44,402,178.64	募集资金专户余额
中国工商银行股份有限公司南京珠江支行	4301027419100157171	1,166.73	普通活期存款利息收入

公司 2023 年上半年度募集资金存放与使用情况符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金的使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。

## 十、控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员和核心技术人员的持股、质押、冻结及减持情况

截至 2023 年 6 月 30 日，公司控股股东为上海蕊测半导体科技有限公司，持有公司 27,032,838 股股份，持股比例为 31.00%。2023 年上半年度，公司控股股东持股数量未发生变化，不存在质押、冻结或减持情况。

2023 年 6 月 27 日，公司董事长、总经理、核心技术人员骈文胜获授限制性股票 5 万股，董事、副总经理、核心技术人员闻国涛获授限制性股票 4 万股，董事、副总经理、核心技术人员路峰获授限制性股票 4 万股，副总经理、董事会秘书、财务总监王沛获授限制性股票 3 万股，副总经理、核心技术人员刘琨获授限制性股票 2.5 万股。

除上述限制性股票授予情况外，截至 2023 年 6 月 30 日，公司实际控制人、董事、监事和高级管理人员和核心技术人员持股数量未发生变化，不存在质押、冻结或减持情况。

## 十一、上海证券交易所或保荐机构认为应当发表意见的其他事项

截至本持续督导跟踪报告出具之日，不存在保荐机构认为应当发表意见的其他事项。

（以下无正文）

（此页无正文，为《方正证券承销保荐有限责任公司关于上海伟测半导体科技股份有限公司 2023 年半年度持续督导跟踪报告》之签章页）

保荐代表人：代礼正  
代礼正

陈寅秋  
陈寅秋

方正证券承销保荐有限责任公司  
2023年9月18日

